

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路制造有限公司*

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯截至二零零五年六月三十日止三個月業績公佈

- 本公司謹於今日公佈截至二零零五年六月三十日止三個月的未經審核經營業績。銷售額由上季的 248,800,000 元升至二零零五年第二季的 279,500,000 元，升幅 12.3%。月產能增至 139,025 片 8 吋等值晶圓。二零零五年第二季的使用率為 87%，二零零五年第一季為 85%。二零零五年第二季的毛利率為 2.3%，二零零五年第一季為 6.1%。二零零五年第二季的淨虧損為 40,400,000 元，二零零五年第一季為淨虧損 30,000,000 元。
- 以下為本公司於二零零五年七月二十九日就截至二零零五年六月三十日止三個月的未經審核業績在美國報章所作的報章公佈全文。
- 本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1) 條規定的披露責任而作出本公佈。

所有貨幣數位主要以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中芯二零零五年第二季業績報告

概要

- 銷售額由上季的 248,800,000 元升至二零零五年第二季的 279,500,000 元，升幅 12.3%。
- 月產能增至 139,025 片 8 吋等值晶圓。
- 二零零五年第二季的使用率為 87%，二零零五年第一季為 85%。
- 二零零五年第二季的晶圓付運比二零零五年第一季增加 16.0% 增至 330,499 片 8 吋等值晶圓。
- 二零零五年第二季的淨虧損為 40,400,000 元，二零零五年第一季則為淨虧損 30,000,000 元。

中國上海—二零零五年七月二十九日—國際主要半導體承包製造商中芯國際積體電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（「中芯」或「本公司」）於今日公佈截至二零零五年六月三十日止三個月的綜合經營業績。二零零五年第二季銷售額由上一季度的 248,800,000 元上升 12.3%至 279,500,000 元。本公司二零零五年第二季的月產能增至 139,025 片 8 吋等值晶圓，使用率為 87%。二零零五年第二季的淨虧損增至 40,400,000 元，二零零五年第一季則為淨虧損 30,000,000 元。

“我們相信 2005 年第二季將是本次半導體周期的谷底，”中芯國際總裁兼總執行長張汝京先生說：“在本季中，公司的財務狀況和我們預期是一致的，儘管整個半導體行業進入不景氣尤其是代工業，但是我們公司在 2005 年第二季的銷售額仍持續增長。基於對我們客戶提供的未來需求預期，我們相信 2005 年下半年公司的財務狀況將有所提高和改善，計劃下的二零零五年資本支出已調增至 1,100,000,000 元。伴隨著 2005 年下半年半導體行業的加速反彈，我們已額外籌集了 600,000,000 元。我們相信此資金加上預計來自經營活動產生的現金流將足以滿足我們 2005 年至 2006 年的資金需求。

本季公司新增加了 20 個客戶，其中一半以上來自中國大陸。我們非常高興地看到來自中國的客戶不斷增長。

在技術前沿，我們 90 納米的第一個定單產品正在按計劃進行質量檢測。沿著技術發展的路線，我們目前正在我們的 12 吋晶圓廠研究開發 65 納米的工藝制程。

今天我們很高興的宣佈兩個獨立的專案。第一個是中芯國際已經和 SAIFUN 半導體建立合作夥伴關係，我們被授權使用其 SAIFUN NROM®技術用於以快閃記憶體為基礎的產品生產。我們新的快閃記憶體的戰略將會使我們能夠滿足以快閃記憶體為基礎的消費電子產品和通訊類電子產品領域的增長的需求。

第二個專案是有關在上海將報廢的晶片回收生產成太陽能模板的工程。我們將會在第三季開始設備安裝，並預期將會在第四季搬入機台設備。

除了我們核心晶片代工事業，我們將繼續尋找各種途徑來提高投資者利益和不斷提升本公司在中國半導體代工業的領先地位。”

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零零五年七月二十九日

時間：上海時間上午八時正

撥號及登入密碼：美國 1-617-614-2714 (密碼：SMIC) 或香港 852-3002-1672 (密碼：SMIC)。

二零零五年第一季業績公佈網上直播可於 www.smics.com 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

有關中芯

中芯國際 (NYSE: SMI, SEHK: 0981.HK) 是世界領先的積體電路晶片代工廠之一，提供 0.35 微米到 0.11 微米及更先進工藝的晶片製造服務。公司 2000 年成立以來，其位於上海及天津的四座 8 英寸晶片均已量產。另外，其位於北京的 12 英寸晶片廠也於 2005 年第一季度開始量產。中芯國際還在美國、歐洲、日本、香港等地設立了辦事處，更好地服務于全球客戶。中芯國際致力於提供高品質的服務，全面執行國際標準，目前已經通過了 ISO9001 認證、ISO/TS16949 認證、OHSAS18001 認證、TL9000 認證以及 ISO14001 認證。如需更多資訊，敬請訪問公司網站：<http://www.smics.com>

安全港聲明

(根據 1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有 (除歷史資料外) 依據 1995 私人有價證券訴訟改革法案所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「計劃」、「估計」、「預計」、「預測」及類似表述為該等前瞻性陳述之標識，為并非所有前瞻性陳述均包含上述字眼。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括 (但不限於) 與半導體行業周期及市場狀況有關的風險、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯量產新產品的能力、半導體承包製造服務供求情況、市場產能過剩、設備、零件及原材料短缺、製造生產量供給及最終市場的金融局勢是否穩定。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會 (「證交會」) 的文件資料，包括其於二零零四年三月十一日以 F-1 表格 (經修訂) 形式呈交予證交會的登記聲明，特別是「風險因素」及「有關財政狀況及經營業績的管理層討論及分析」兩個部份、其於二零零四年三月八日以 A-1 表格形式呈交予香港聯合交易所 (「香港聯交所」) 的登記聲明，以及中芯可能不時向證交會及香港聯交所呈交的該等其他文件，包括 6-K 表格。其他未知或不可逆料的因素亦可能會對中芯日後的業績、表現或成就造成重大不利影響。鑒於上述風險、不確定性、假設及因素，

本新聞發佈中提及的前瞻性事件可能不會發生。務請閣下注意，切勿過份依賴此等前瞻性陳述，此等陳述僅就本新聞發佈中所載述日期（或如無有關日期，則本新聞發佈日期）的情況而表述。

除法律有所規定以外，中芯概不就因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況承擔任何責任，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

投資者聯絡資料：

Jimmy Lai

投資者關係部負責人

電話：86-21-5080-2000，內線 16088

傳真：86-21-5080-3619

Calvin Lau

投資者關係部

電話：86-21-5080-2000，內線 16693

傳真：86-21-5080-3619

概要：

以千美元為單位（每股盈利和百分比除外）

	<u>二零零五年</u> <u>第二季度</u>	<u>二零零五年</u> <u>第一季度</u>	<u>季度比較</u>	<u>二零零四年</u> <u>第二季度</u>	<u>年度比較</u>
銷售	279,500	248,808	12.3%	220,988	26.5%
銷售成本	273,111	233,696	16.9%	158,247	72.6%
毛利	6,389	15,112	-57.7%	62,741	-89.8%
經營開支	38,469	37,086	3.7%	26,351	46.0%
經營溢利	(32,081)	(21,794)	46.0%	36,390	-
其他收入	(8,234)	(8,012)	2.8%	(2,225)	270.1%
所得稅	118	9	1259.3%	-	-
收入（虧損）淨額	(40,433)	(29,995)	34.8%	34,165	-218.4%
少數股權	(12)	-	-	-	-
普通股持有人應占收入	(40,445)	(29,995)	34.8%	34,165	-
毛利率	2.3%	6.1%		28.4%	
經營利潤率	-11.5%	-8.8%		16.5%	
每股基本盈利－每股普通股(1)	(\$0.0022)	(\$0.0017)		\$0.0019	
每股基本盈利－每股美國預托股份	(\$0.1113)	(\$0.0831)		\$0.0955	
每股攤薄盈利－每股普通股	(\$0.0022)	(\$0.0017)		\$0.0019	
每股攤薄盈利－每股美國預托股份	(\$0.1113)	(\$0.0831)		\$0.0941	
付運晶圓（8吋等值）(2)	330,499	284,912	16.0%	201,534	64.0%
綜合平均售價	\$807	\$829	-2.7%	\$1,034	-22.0%
邏輯平均售價(3)	\$938	\$967	-3.0%	\$1,089	-13.9%
產能使用率	87%	85%		99%	

附注：

(1) 基於二零零五年第二季加權平均普通股 18,169,000,000 股，二零零五年第一季 18,054,000,000 股，二零零四年第二季 17,897,000,000 股。

(2) 包括銅接連件

(3) 不包括銅接連件

- 二零零五年第二季銷售額升至 279,500,000 元，較二零零五年第一季的 248,800,000 元錄得季度升幅 12.3%，並較二零零四年第二季的 221,000,000 元錄得年度升幅 26.5%。導致此等上升的主要因素如下：

- 月產能增至 139,025 片 8 吋等值晶圓

- 8 吋等值晶圓付運升至 330,499 片，較二零零五年第一季的 284,912 片錄得季度升幅 16.0%；

- 產能使用率增至 87%

- 爲了使財務狀況披露和其他高科技公司的慣例更爲一致，公司已經追溯調整了部分費用的重新分類。這裏所有列出的數位都適用於這次重新分類。具體地來說，攤銷費用（主要是和訴訟和解有關的專利許可協定及其他許可協定）之前是認列在銷售成本及研發費用中，現將此費用在經營開支中單列爲無形資產攤銷費用。由於費用的重新分類使二零零五第一季的銷售成本減少 6,600,000，研發相關費用減少 3,300,000 及無形資產攤銷費用增加 9,900,000。
- 重新分類後的銷售成本從二零零五年第一季的 233,700,000 元增加 16.9%至二零零五年第二季的 273,100,000 元，主要由於晶圓付運和折舊費用增加。
- 二零零五年第二季毛利降至 6,400,000 元，較二零零五年第一季的 15,100,000 元錄得季度降幅 57.7%。
- 重新分類後的毛利率從二零零五年第一季的 6.1%降至二零零五年第二季 2.3%，主要是折舊費用的增加和由於 DRAM 的價格下調和整個行業的疲軟造成的綜合 ASP 的下降。
- 重新分類後的研發費用從二零零五年第一季的 14,600,000 元上升 11.6%至二零零五年第二季 16,300,000 元，主要是由於 90 納米和 65 納米的研究開發行爲所致。
- 一般行政費用(包括匯兌損益)從二零零五年第一季 6,600,000 元下降 18.1%至二零零五年第二季 5,400,000 元，主要是由於訴訟費用的減少。
- 銷售及市場推廣相關費用從二零零五年第一季 2,500,000 元上升 20.8%至二零零五年第二季 3,000,000 元，主要是因爲與銷售行爲相關的工程材料費用的增加。
- 重新分類後的無形資產攤銷費用從二零零五年第一季 9,900,000 元上升 2.2%至二零零五年第二季 10,100,000 元。
- 二零零五年第二季的經營虧損爲 32,100,000 元，二零零五年第一季經營虧損 22,000,000 元。
- 其他非營業性虧損由二零零五年第一季的 8,000,000 元增加爲二零零五年第二季的 8,200,000 元，主要是因爲利息費用的增加。
- 二零零五年第二季的利息支出由二零零五第一季的 7,700,000 元增加 16.7%至 9,000,000 元，主要是由於銀行借款的增加。
- 匯兌淨收益爲 900,000 元，其中一般行政費用中包括了匯兌收益 2,500,000 元與融資或投資活動相關的非經營性活動產生的匯兌虧損 1,600,000 元歸類爲其他經營性溢利（虧損）。
- 二零零五年第二季淨損失爲 40,400,000 元，二零零五年第一季爲淨損失 30,000,000 元。

1. 收入分析

銷售分析					
以應用分類	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季	二零零四年 第四季	二零零四年 第三季	二零零四年 第二季
電腦	39.8%	36.8%	26.8%	20.5%	22.5%
通訊	40.4%	44.5%	58.1%	57.2%	54.3%
消費	15.2%	13.6%	10.2%	17.1%	17.1%
其他	4.6%	5.1%	4.9%	5.2%	6.1%
以裝置分類	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季	二零零四年 第四季	二零零四年 第三季	二零零四年 第二季
邏輯（包括銅接連件）	58.9%	61.9%	75.1%	77.6%	73.5%
DRAM（1）	36.5%	33.0%	20.4%	17.5%	20.8%
其他（光罩製造及探測）	4.6%	5.1%	4.5%	4.9%	5.7%
以客戶類別分類	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季	二零零四年 第四季	二零零四年 第三季	二零零四年 第二季
非廠房半導體公司	42.2%	48.1%	50.2%	35.3%	36.1%
集成裝置製造商	55.2%	49.6%	47.5%	56.3%	54.8%
系統公司及其它	2.6%	2.3%	2.3%	8.4%	9.1%
以地區分類	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季	二零零四年 第四季	二零零四年 第三季	二零零四年 第二季
北美洲	40.8%	40.4%	34.9%	41.8%	44.0%
亞太區（不包括日本）	26.3%	26.9%	43.5%	31.5%	26.5%
日本	6.0%	8.0%	8.8%	15.6%	16.2%
歐洲	26.9%	24.7%	12.8%	11.1%	13.3%
晶圓收入分析					
以技術分類 （僅包括邏輯、記憶及銅連接件）	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季	二零零四年 第四季	二零零四年 第三季	二零零四年 第二季
0.13 微米	44.5%	29.2%	13.8%	11.9%	9.9%
0.15 微米	2.5%	12.5%	14.9%	13.2%	13.3%
0.18 微米	40.7%	40.3%	33.6%	46.2%	48.6%
0.25 微米	3.9%	4.6%	6.0%	6.4%	8.3%

0.35 微米	8.4%	13.4%	31.7%	22.3%	19.9%
	<u>二零零五年</u>	<u>二零零五年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>二零零四年</u>	<u>二零零四年</u>
以邏輯分類 (2)	<u>第二季</u>	<u>第一季</u>	<u>第四季</u>	<u>第三季</u>	<u>第二季</u>
0.13 微米	12.6%	5.4%	2.4%	1.8%	0.9%
0.15 微米	4.8%	2.2%	5.3%	4.6%	3.9%
0.18 微米	59.4%	59.8%	38.2%	56.2%	63.0%
0.25 微米	7.1%	7.1%	7.8%	6.1%	3.1%
0.35 微米	16.1%	25.5%	46.3%	31.3%	29.1%

附注：

(1) 先前所用的是“記憶體”一詞，但是所有歷史報告在這個類別中都僅僅包括 DRAM 裝置。

• (2) 不包括 0.13 微米銅接連件

• 二零零五年第二季源自歐洲客戶的銷售百分比增長最快上升至 26.9%，二零零五年第一季度則為 24.7%。

• 二零零五年第二季 0.18 微米及以下技術晶圓的銷售百分比上升至 87.7%，二零零五年第一季度為 82.0%而二零零四年第二季度為 71.8%。

• 二零零五年第二季 0.18 微米及以下技術邏輯晶圓的銷售占邏輯晶圓銷售的百分比上升至 76.8%，二零零五年第一季度為 67.4%而二零零四年第二季度為 67.8%。

• 二零零五年第二季 0.13 微米的邏輯晶圓的銷售占邏輯晶圓銷售的百分比從二零零五年第一季度的 5.4%顯著上升至 12.6%，而 0.35 微米的邏輯晶圓的銷售占邏輯晶圓銷售的百分比從二零零五年第一季度的 25.5%下降至 16.1%

• 產能：

<u>廠 / (晶圓尺寸)</u>	<u>二零零五年第二季⁽¹⁾</u>	<u>二零零五年第一季⁽¹⁾</u>
一廠 (8 吋)	45,000	45,731
二廠 (8 吋)	43,045	40,000
四廠 (12 吋)	16,787	10,220
七廠 (8 吋)	15,000	16,221
每月晶圓裝配總產能	119,832	112,172
銅接連件：		

三廠（8吋）	19,193	19,000
每月銅接連件總產能	19,193	19,000

注（1）期終每月晶圓計，8吋等值

• 截至二零零五年第二季度末，基於一定的產品組合每月產能增加至 139,025 件 8 吋等值晶圓。

付運及使用率：

8吋晶圓	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季	二零零四年 第四季	二零零四年 第三季	二零零四年 第二季
付運晶圓（包括銅接連件）	330,499	284,912	303,796	263,808	201,534
使用率 ⁽¹⁾	87%	85%	95%	99%	99%

附注：

(1) 使用率按輸出品圓總額除以估計產能計算

- 二零零五年第二季晶圓付運增加至 330,499 片 8 吋等值晶圓，分別較二零零五年第一季的 284,912 片及二零零四年第二季度的 201,534 片分別上升 16.0%及上升 64.0%。
- 二零零五年第二季使用率上升至 87%。

綜合平均售價趨勢

邏輯平均售價趨勢（不包括 0.13 微米銅接連件）

二零零五年第二季綜合平均售價分別由二零零五年第一季的 829 元及二零零四年第二季的 1034 元下降至 807 元，主要原因在於 DRAM 的價格下調和整個行業的疲軟。

二零零五年第二季邏輯平均售價（不包括 0.13 微米銅接連件）由二零零五年第一季的 967 元及二零零四年第二季的 1,089 元下降至 938 元，主要原因在於整個行業的疲軟及晶圓代工企業嚴峻的競價環境。

2. 詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季	季度比較	二零零四年 第二季	年度比較
銷售成本	273,111	233,696	16.9%	159,247	72.6%
折舊	171,216	145,307	17.8%	83,990	103.9%
其他製造成本	101,895	88,389	15.3%	74,257	37.2%
毛利	6,389	15,112	-57.7%	62,741	-89.8%
毛利率	2.3%	6.1%		28.4%	

- 在重分類影響下，銷售成本從二零零五年第一季的 233,700,000 元增加 16.9% 至二零零五年第二季的 273,100,000 元，主要由於折舊費用及晶圓付運數量增加。
- 毛利從二零零五年第一季的 15,100,000 元下降 57.7% 至二零零五年第二季 6,400,000 元
- 在重分類影響下，毛利率從二零零五年第一季的 6.1% 降至二零零五年第二季 2.3%，主要是由於折舊費用的增加和由於 DRAM 的價格下調和整個行業的疲軟造成的綜合 ASP 的下降。

經營開支分析

以千美元計	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季	季度比較	二零零四年 第二季	年度比較
總經營開支	38,469	37,086	3.7%	26,351	46.0%
研究及開發	16,344	14,646	11.6%	11,261	45.1%
一般及行政	5,397	6,591	-18.1%	6,019	-10.3%
銷售及市場推廣	3,012	2,494	20.8%	1,940	55.3%
無形資產攤銷	10,082	9,869	2.2%	3,532	185.5%
遞延股份報酬攤銷	3,634	3,487	4.2%	3,599	1.0%

- 總經營開支從二零零五年第一季的 37,100,000 元升至 38,500,000 元，錄得季度升幅 3.7%。
- 在重分類影響下，二零零五年第二季研發費用上升至 16,300,000 元，比二零零五年第一季的 14,600,000 元上升了 11.6%，主要是由於 90 納米和 65 納米的研究開發活動所致。
- 一般行政費用(包括匯兌損益)從二零零五年第一季 6,600,000 元下降 18.1% 至二零零五年第二季 5,400,000 元，差額主要因為訴訟費用的減少。

- 銷售及市場推廣相關費用從二零零五年第一季 2,500,000 元上升 20.8%至二零零五年第二季 3,000,000 元，差額主要因為與銷售行為相關的工程材料費用的增加。
- 重新分類的無形資產攤銷費用在二零零五年第二季上升至 10,100,000，較二零零五年第一季 9,900,000 上升了 2.2%

非經營收入（支出）

以千美元計	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季	季度比較	二零零四年 第二季	年度比較
其他收入(支出)	(8,234)	(8,012)	2.8%	(2,225)	270.1%
利息收入	2,030	1,928	5.3%	2,733	-25.7%
利息支出	(8,971)	(7,688)	16.7%	(2,760)	225.1%
其他，淨額	(1,293)	(2,252)	-42.6%	(2,198)	-41.1%

- 其他非營業性虧損由二零零五年第一季的 8,000,000 元增加為本季的 8,200,000 元。主要是因為利息費用的增加。
- 二零零五年第二季的利息支出由二零零五第一季的 7,700,000 元增加 16.7%至 9,000,000 元，主要是由於銀行借款的增加。

3. 流動資金

以千美元計	二零零五年第二季	二零零五年第一季
現金及現金等價物	576,292	438,802
短期投資	2,768	10,349
應收賬款	196,132	180,878
存貨	176,502	174,525
其他	16,397	8,565
總流動資產	968,091	813,119
應付賬款	249,595	333,442
短期借款	224,000	133,499
長期借款的即期部份	228,625	228,625
其他	96,746	88,872
總流動負債	798,966	784,438
現金比率	0.7x	0.6x

速動比率	1.0x	0.8x
流動比率	1.2x	1.0x

- 現金及現金等價物由 438,800,000 元升至 576,300,000 元，主要由於銀行借款增加。

應收賬款／存貨的各日走勢

資本結構

以千美元計	二零零五年第二季	二零零五年第一季
現金及現金等價物	576,292	438,802
短期投資	2,768	10,349
長期票據的即期部分	19,090	4,833
長期票據	116,204	129,310
短期借款	224,000	133,499
長期借款的即期部份	228,625	228,625
長期借款	511,807	411,824
總借款	964,432	773,948
現金淨額	(520,666)	(458,940)
股東權益	3,053,111	3,086,256
總借款對權益比率	31.6%	25.1%

- 總借款由二零零五年第一季的 773,900,000 元升至二零零五年第二季的 964,400,000 元，主要是銀行借款的增加。
- 總借款對權益比率由二零零五年第一季的 25.1% 上升至二零零五年第二季的 31.6%。

4. 現金流量及資本開支

以千美元計	二零零五年第二季	二零零五年第一季
虧損淨額	(40,445)	(29,995)
折舊及攤銷	185,978	166,243
購入無形資產攤銷	10,082	9,869

資本開支計劃

- 二零零五年第二季資本開支為 141,300,000 元，二零零五年上半年資本開支為 484,400,000 元。
- 計劃下的二零零五年資本開支已調增至 1,100,000,000 元左右，並且將根據市場情況做相應調整。

5. 二零零五年第三季指引

- 晶圓付運預期增長 7.5%-9.5%。
- 使用率預計上升約至 90%-93%。
- 綜合 ASP 預計上升 8%-10%。
- 毛利預計上升 12%-15%。
- 經營開支相對銷售的百分比預計為百分之十五左右。
- 無形資產攤銷預計約為 11,000,000
- 非營業性支出預計約為 10,000,000
- 資本開支約為 200,000,000 - 240,000,000 元。
- 折舊及攤銷約為 200,000,000 元至 210,000,000 元。
- 遞延股票報酬攤銷約為 7,000,000 元，其中約 4,000,000 元將於經營開支中列支，3,000,000 元將於銷售成本列支。

6. 近期公佈

- 中芯國際被授權使用 SAIFUN NROM®技術用於擴展公司半導體業務。(二零零五年七月二十八日)
- 董事會主席變更 (二零零五年七月二十八日)
- 中芯國際與新思科技有限公司發佈設計參考流程 2.0 (二零零五年七月二十日)

- 中芯國際與 Magma 建立設計服務合作關係, 為納米設計提供完整的 RTL 到 GDSII 解決方案和服務 (二零零五年六月二十八日)
- 中芯國際應用安捷倫 EDA 軟體提供 0.18 微米 CMOS 工藝全新設計工具集 (二零零五年六月九日)
- 中芯北京取得擴張所需資金 (二零零五年五月二十六日)
- 中芯國際集成 ARM926EJ 處理器晶片成功通過認證 (二零零五年五月二十五日)
- 二零零五年五月六日舉行之股東周年常會, 投票表決結果 (二零零五年五月六日)
- 中芯國際和聯合科技在中國合資建立晶片封裝及測試服務公司 (二零零五年五月三日)
- 中芯國際 2005 年第一季業績報告 (二零零五年四月二十九日)
- 合資格會計師豁免 (二零零五年四月二十九日)
- 中芯國際加入 ARM Connected Community (二零零五年四月二十七日)

上述公布詳情請參閱中芯網站 www.smics.com。

中芯財務資料

合并資產負債表
(美元)

	截至以下日期止三個月	
	二零零五年六月三十日 (未經審核)	二零零五年三月三十一日 (未經審核)
資產		
流動資產：		
現金及現金等價物	576,292,179	438,801,533
短期投資	2,768,085	10,349,390
應收賬款，已扣除撥備（二零零五年六月三十日為109,362元，二零零五年三月三十一日為342,768元）	196,132,014	180,877,544
存貨	176,502,315	174,525,252
預付款項及其它流動資產	14,564,660	6,732,846
待售資產	1,831,972	1,831,972
流動資產合計	968,091,225	813,118,537
土地使用權，淨額	38,758,108	38,976,538
廠房及設備，淨額	3,309,941,020	3,354,240,115
購入無形資產，淨額	192,817,289	202,682,671
長期投資	9,524,730	2,810,309
資產合計	4,519,132,372	4,411,828,170
負債及股東權益		
流動負債：		
應付帳款	249,594,589	333,442,304
預提費用及其它流動負債	77,655,608	84,038,636
短期借款	224,000,435	133,498,761
長期票據的即期部份	19,090,094	4,833,421
長期借款的即期部份	228,625,170	228,625,170
流動負債合計	798,965,896	784,438,292
長期負債：		

長期票據	116,203,745	129,309,552
長期借款	511,806,547	411,824,480
長期負債合計	628,010,292	541,134,032
負債合計	1,426,976,188	1,325,572,324
承諾		
少數股權	39,044,852	-
股東權益：		
普通股，面值 0.0004 元，法定股份為 50,000,000,000 股，截止二零零五年六月三十日 已發行股份為 18,246,615,105 股，未發行的股份 為 18,233,297,823 股。	7,298,647	7,293,320
認股權證	32,387	32,387
額外繳入股本	3,289,932,622	3,289,197,990
應收股東票據	(287,629)	(339,157)
累計其他綜合盈餘	67,782	245,959
遞延股票報酬	(37,107,243)	(43,794,707)
累計虧絀	(206,825,234)	(166,379,946)
所有股東權益合計	3,053,111,332	3,086,255,846
總負債及股東權益合計	4,519,132,372	4,411,828,170

合并營運報表
(美元)

	截至以下日期止三個月	
	二零零五年六月三十日 (未經審核)	二零零五年三月三十一日 (未經審核)
銷售額	279,500,151	248,808,088
銷售成本	270,068,286	230,522,130
銷售成本—遞延股票報酬攤銷	3,043,259	3,173,661
毛利	6,388,606	15,112,297
經營費用：		
研究和開發	16,343,815	14,645,779
一般管理	5,396,571	6,591,065
銷售和市場推廣	3,012,598	2,493,753
無形資產攤銷	10,081,688	9,868,813
遞延股票報酬攤銷*	3,634,441	3,486,827
經營費用總額	38,649,113	37,086,238
經營虧損	(32,080,507)	(21,973,941)
其他收入(支出)：		
利息收入	2,029,899	1,928,135
利息支出	(8,970,776)	(7,688,304)
其他淨額	(1,293,508)	(2,252,173)
其他淨收入(支出)總額	(8,234,385)	(8,012,342)
稅前虧損淨額	(40,314,892)	(29,986,283)
所得稅	118,449	8,714
少數股權	(11,947)	-
淨虧損	(40,445,288)	(29,994,997)
視為已派付優先股股息	-	-

普通股持有人應占虧損淨額	(40,445,288)	(29,994,997)
每股股份收入淨額，基本	(0.0022)	(0.0017)
每股美國預托股份收入淨額，基本(1)	(0.1113)	(0.0831)
每股股份收入淨額，攤薄	(0.0022)	(0.0017)
每股美國預托股份收入淨額，攤薄(1)	(0.1113)	(0.0831)
用作計算基本每股收入淨額的股份（以百萬計）	18,169	18,054
用作計算攤薄每股收入淨額的股份（以百萬計）	18,169	18,054
* 遞延股票報酬攤銷乃關於：		
研究和開發	1,246,376	1,309,708
一般和管理	1,810,959	1,573,391
銷售及市場推廣	577,106	603,728
總計	3,634,441	3,486,827

(1) 一股美國預托股份等於 50 股普通股。

合并现金流量表
(美元)

	截至以下日期止三個月	
	二零零五年六月三十日 (未經審核)	二零零五年三月三十一日 (未經審核)
經營活動：		
普通股持有人應占虧損	(40,445,288)	(29,994,997)
視為已派付優先股息	-	-
淨虧損	(40,445,288)	(29,994,997)
淨虧損至經營活動所得(所耗)現金淨額對賬的調整：		
少數股權	11,947	-
出售廠房及設備的收益(虧損)	23,609	(3,434)
(沖銷)呆賬撥備	(233,406)	(762,397)
折舊及攤銷	185,977,726	166,242,887
購入無形資產攤銷	10,081,688	9,868,813
遞延股票報酬攤銷	6,677,700	6,660,488
非現金應付票據利息費用	1,150,866	1,173,682
長期投資虧損	5,579	69,691
營運資產及負債的變動：		
應收賬款	(15,021,064)	(10,926,860)
存貨	(1,977,063)	(30,507,400)
預付款及其它流動資產	(7,684,704)	5,873,806
應付賬款	(872,935)	8,296,980
應付所得稅	-	(152,000)
預提費用及其它流動負債	(2,661,260)	13,982,097
經營活動所得現金淨額	135,033,395	139,821,356
投資活動：		
購入廠房及設備	(227,154,585)	(248,495,009)
購買購入無形資產	(2,353,756)	(2,400,500)
購入短期投資	(2,416,480)	-
長期投資已付款項	(6,720,000)	(2,880,000)
出售短期投資	10,000,000	9,932,932

待售資產已收款項	1, 111, 677	1, 878, 435
出售廠房及設備收到款項	-	1, 089
投資活動所耗現金淨額	(227, 533, 144)	(241, 963, 053)
融資活動：		
短期借款所得款項	145, 540, 347	28, 475, 559
長期借款所得款項	99, 943, 394	92, 498, 781
償還應付票據支付的款項	-	(25, 000, 000)
償還長期借款支付的款項	-	(124, 474, 375)
償還短期借款支付的款項	(55, 000, 000)	(50, 000, 000)
行使雇員購股權所得款項	777, 415	196, 032
收取雇員應收認購款項	51, 529	52, 218
少數股權所得款項	39, 000, 025	12, 082, 400
融資活動所得現金淨額	230, 312, 710	(66, 169, 385)
彙率變動的影響	(322, 315)	(59, 955)
現金及現金等價物減少淨額	137, 490, 646	(168, 371, 037)
現金及現金等價物—二零零五年四月一日	438, 801, 533	607, 172, 570
現金及現金等價物—二零零五年六月三十日	576, 292, 179	438, 801, 533

於本公佈刊發日期，本公司董事分別有董事會主席及獨立非執行董事王陽元、執行董事張汝京、非執行董事蔡來興、姚方（蔡來興的替任董事）、及獨立非執行董事徐大麟、周延鵬、川西剛、蕭崇河及陳立武。

承董事會命
中芯國際積體電路製造有限公司
首席執行官
張汝京
上海，二零零五年七月二十九日

* 僅供識別